



NXP, 아너 매직 V 스마트폰에서 고급 와이파이 6 성능 구현

- NXP WLAN7207H 프런트엔드 모듈, 디자인·프리미엄 와이파이 6·블루투스 성능 결합한 고성능 스마트폰 지원

2022년 7월 14일, 대한민국 서울 – NXP반도체는 WLAN7207H 2.4GHz 프런트엔드 집적 회로(FEIC)를 통해 아너(Honor)의 플래그십인 매직(Magic) V 스마트폰에서 와이파이(Wi-Fi) 6을 활용할 수 있게 됐다고 발표했다. NXP WLAN7207x 싱글 FEM 제품군은 라우팅과 인쇄 회로 기판(PCB) 설계 유연성을 제공해 스마트폰에서 최적화된 RF 성능을 구현한다.



소비자의 요구를 충족시키기 위해 스마트폰의 기능이 다양해짐에 따라 아키텍처와 PCB 설계 난이도는 점차 높아졌다. 소비자들은 블루투스와 와이파이 6 성능 측면 모두를 지원하는 더 발전된 기기를 원한다. 즉 소비자가 만족할 만한 스마트폰은 짧은 레이턴시와 높은 네트워크 용량 및 효율 등 이전 세대보다 향상된 기능을 갖춰야 하는 것이다. WLAN7207x 싱글 FEM 제품군은 설계자에게 라우팅과 PCB 배치에 폭 넓은 자유를 제공해 더 높은 와이파이 6와 블루투스 성능을 지원하는 RF를 최적화한다.

NXP 스마트 안테나 솔루션 부사장 겸 총괄 도에코 테르프스트라(Doeco Terpstra)는 "소비자들이 지속적으로 증가하는 데이터 기반의 이점들을 누리기 위해 스마트폰에 의존하게 되면서, 전송해야 하는 데이터의 양과 디바이스의 수가 급격하게 늘어나고 있다. 와이파이 6는 이러한 문제에 대한 우리의 해답이다. 우리 FEIC 솔루션은 소비자가 원하는 와이파이 6 성능 이점을 제공하는 동시에, OEM에 필요한 설계 유연성을 제공한다"고 말했다.



아너(Honor) CEO 조지 자오(George Zhao)는 "스마트폰의 기능이 풍부해지면서 폼팩터(form-factor)가 소비자들의 눈에 들기 위한 차별점이 됐다. NXP의 FEM 솔루션을 통해 와이파이 6와 관련된 더 긴 전송 범위와 향상된 신호 품질을 제공하면서 플래그십 전화 설계로 인해 증가하는 복잡성과 과제를 극복할 수 있다"고 말했다.

자세한 내용은 [NXP 사이트](#)에서 확인할 수 있다.

###

NXP 반도체 소개

NXP®반도체(나스닥: NXPI)는 혁신을 통해 더욱 스마트하고 안전하며 지속 가능한 세상을 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 31,000명의 직원을 고용하고 있다. 2021년 매출은 미화 110억 6천만 불이다. 더 자세한 내용은 www.nxp.com에서 찾아볼 수 있다.